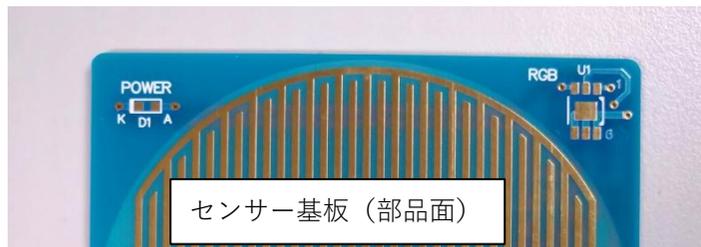
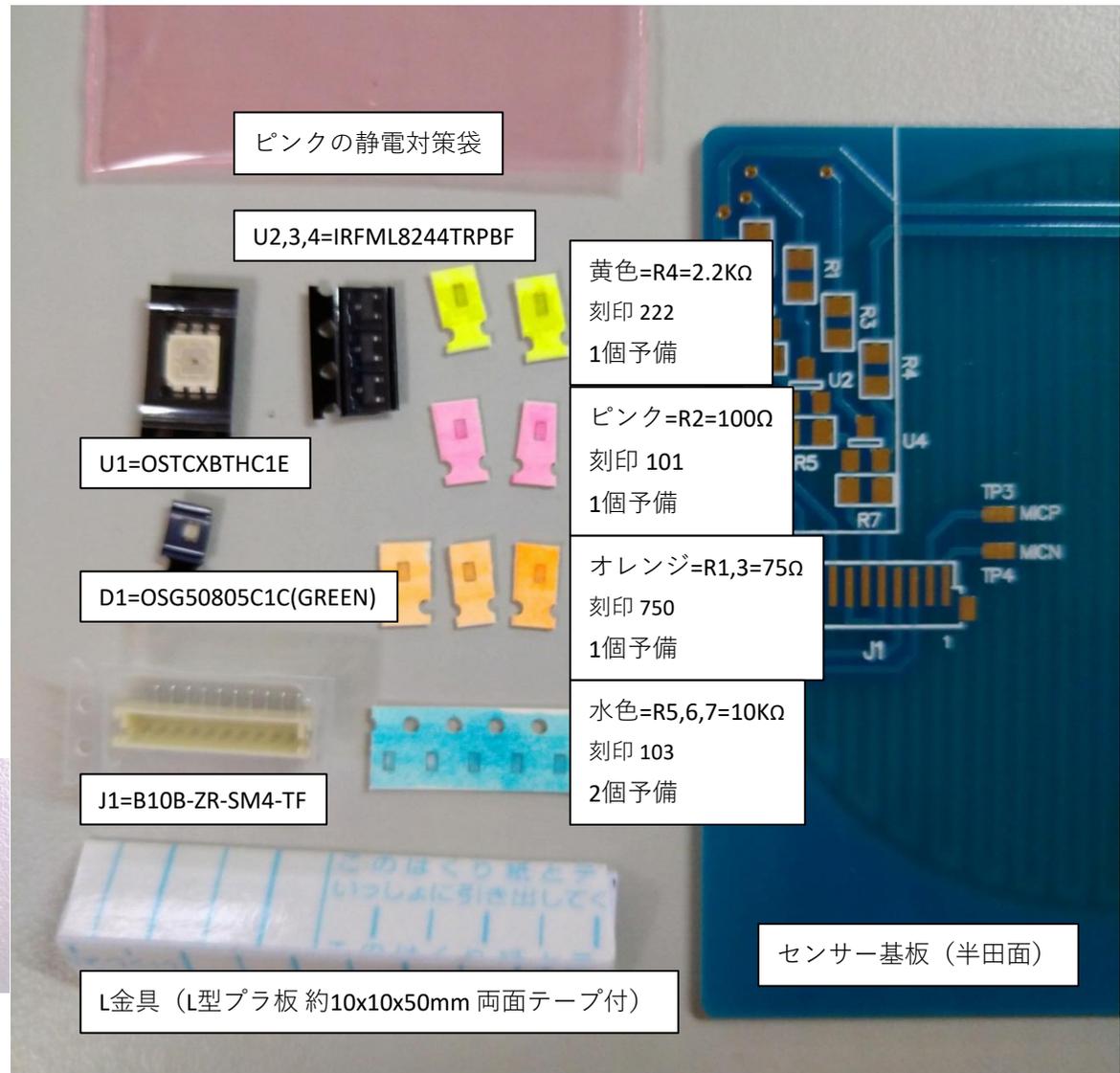


# センサーキット外観

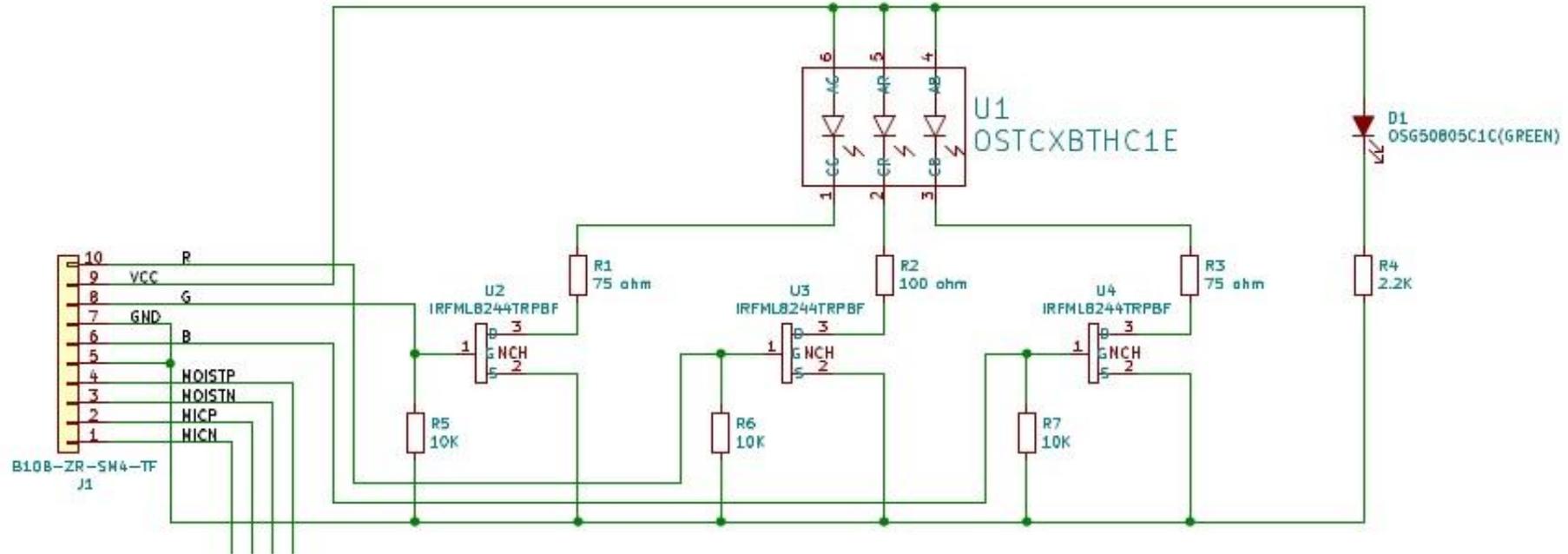
# 内容物の確認、部品番号と部品名 (定数)



センサー基板 (部品面)

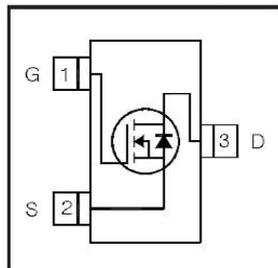


# センサー基板の回路図（半田付けに関する部分抜粋）と主要部品資料

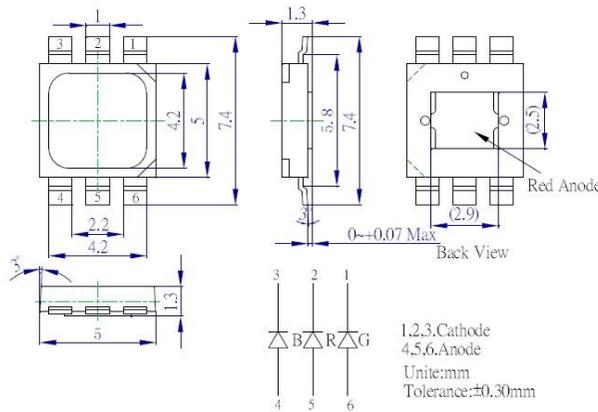


## IRFML8244TRPbF

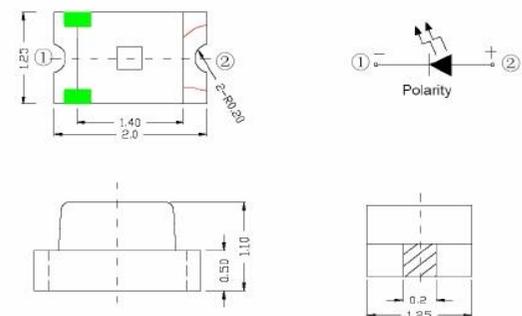
HEXFET® Power MOSFET



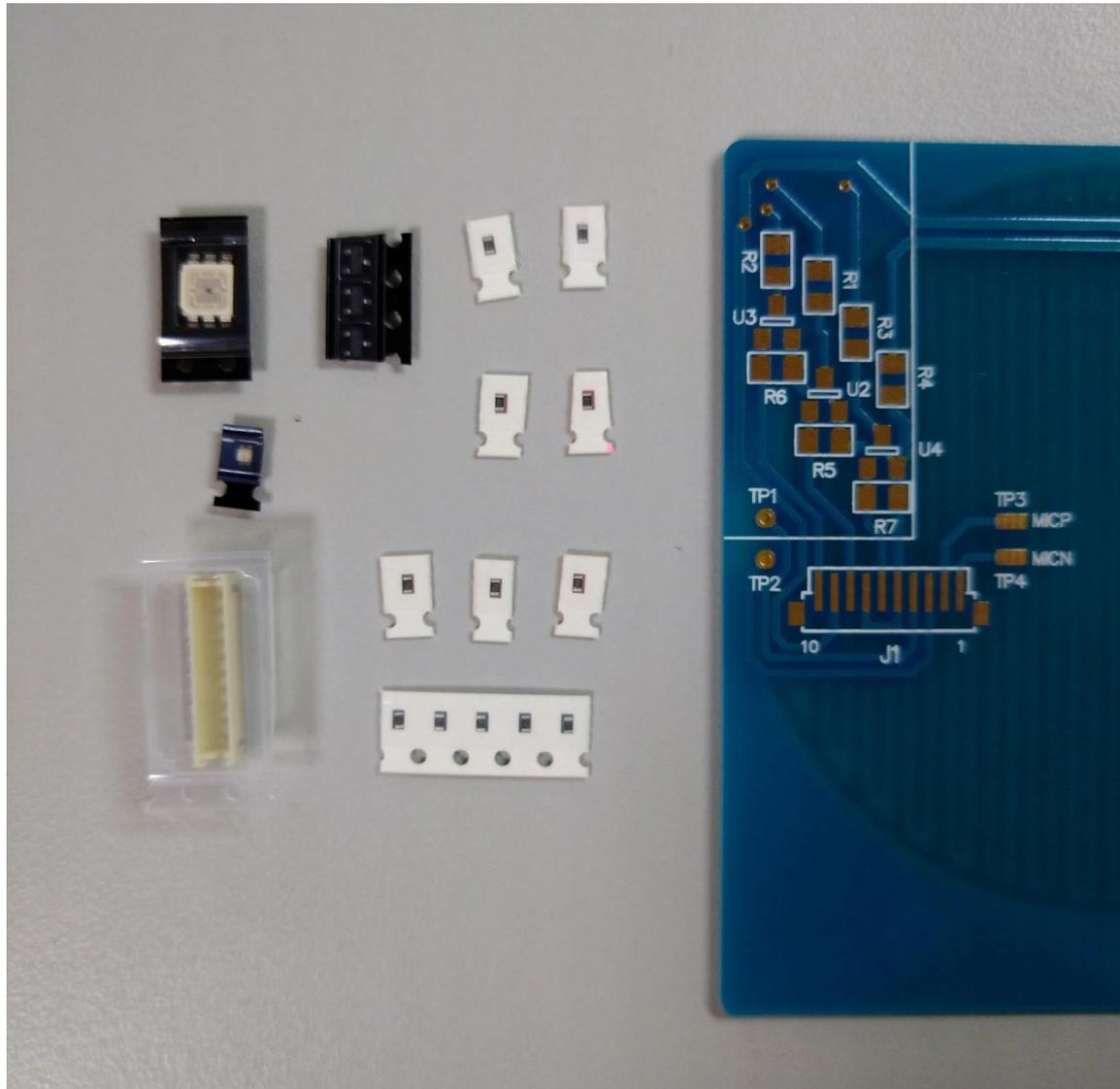
FETは回路シンボルと現物のピン配置が異なります。



## ■Outline Dimension



部品は透明な保護シールを剥がして取り出します。（半田付け直前に）



部品は、ピンセット等で、表面の薄い、透明なシールを剥がして、下に向けて部品を落として取り出します。

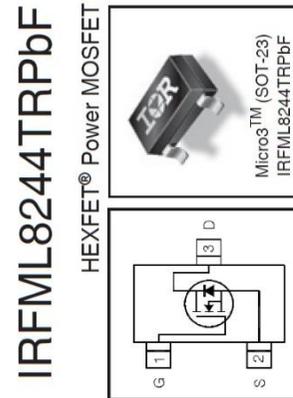
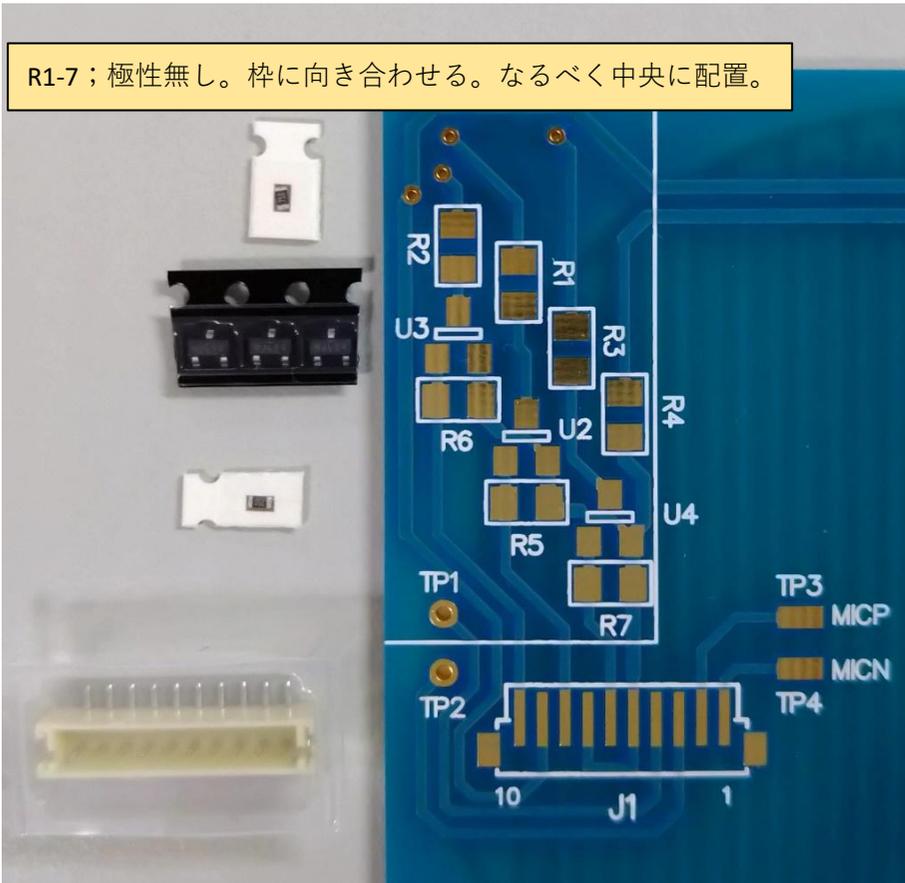
抵抗の値は紙の色分けで確認します。（前ページ参照）。抵抗は無くさないように、混在しないように注意してください。1種類ずつ剥がして使うようにしましょう。

万が一、抵抗が混在した場合は、抵抗の表面に小さく刻印してあるので、ルーペを使って確認可能です。前ページ参照。

ルーペが無い場合は、スマホ等で出来るだけ接近して撮影して、出来るだけ大きく拡大して読みます。

黒い梱包の部品が半導体で、静電気に注意します。湿った感じの新聞紙等を敷き、電池式の半田コテの使用がお勧めです。

# 部品の配置、向き、形状

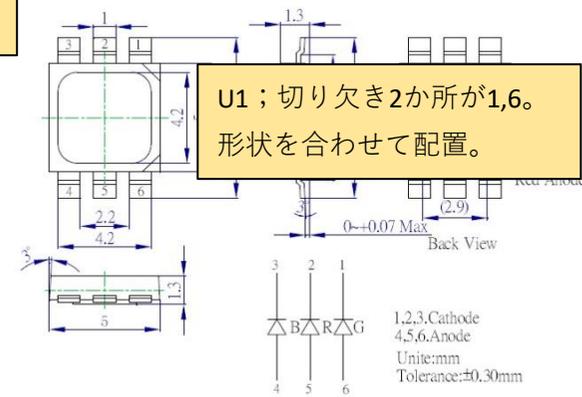
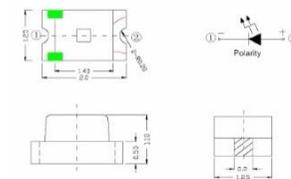


U2,3,4; 足1本が3:D, 足2本が1:Gと2:S。  
形状を合わせて配置。

全て上から見た図  
(Top View)

J1; 形状を合わせて配置。  
J1の側の直線を合わせる。

D1; 緑色のマークがK。  
なるべく中央に配置。



U1; 切り欠き2か所が1,6。  
形状を合わせて配置。

## センサー基板の部品半田付け。完了写真。

この完了写真を参考に。部品の足の底面・端面と基板の金メッキの接点に半田を溶かして半田付けします。



J1が背が高いので、こちらの面を先に半田付けします。

剥がし易いテープでマスキングしておく会更好です。

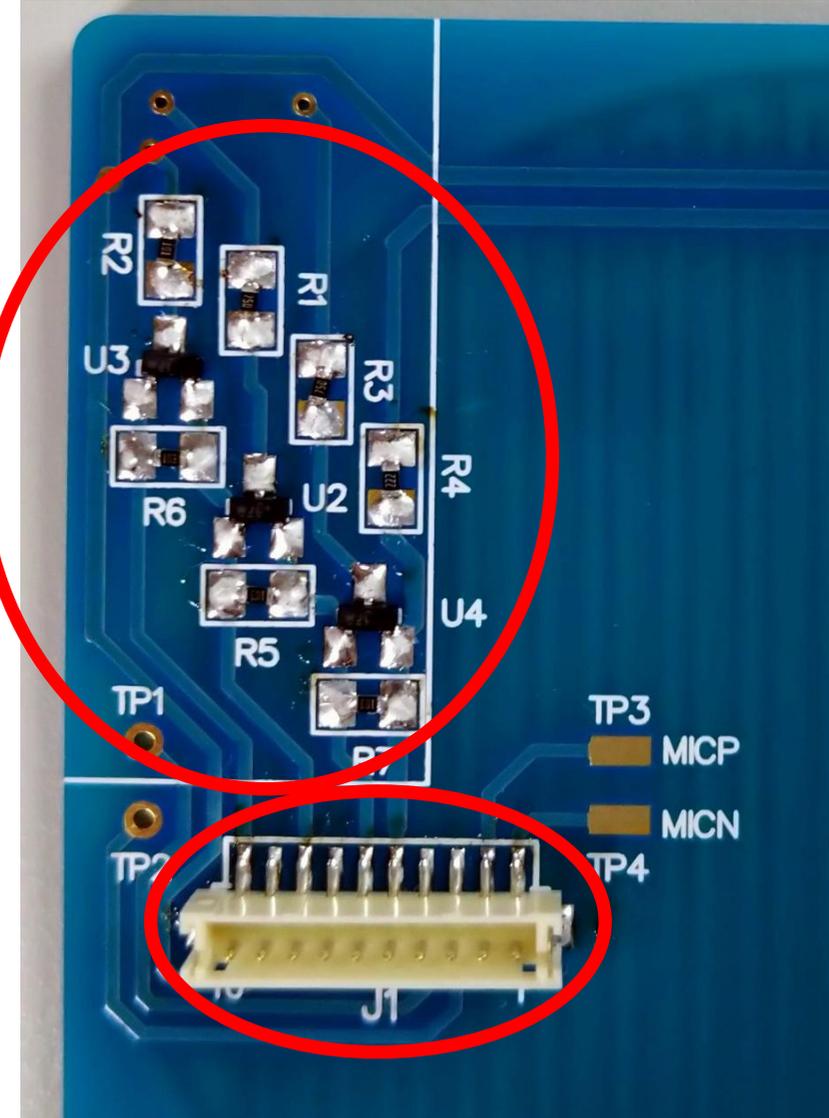


部品はピンセットで持ちます。ルーペがあると便利です。

どの部品も、先ずどれかのピンを1本だけ半田付けし、位置を決めます。

残りのピンを半田付けします。最初のピンを半田付けし直します。

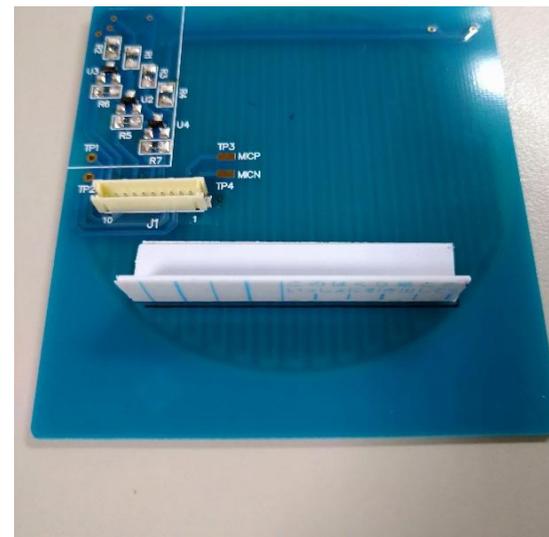
部品が傾いたり、浮かないように注意しましょう。



L金具の貼り付け位置のマーキング、貼り付け。



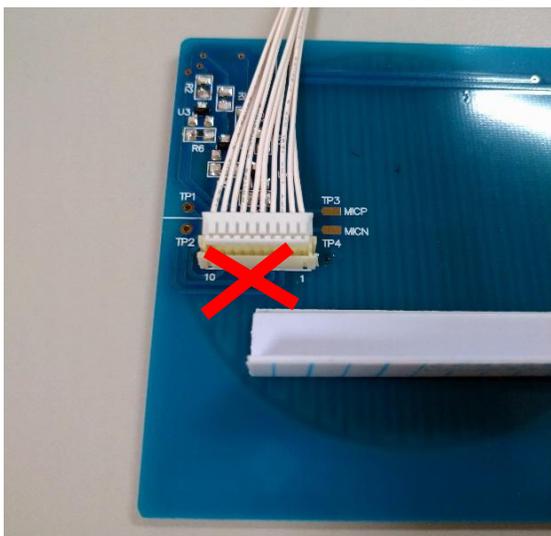
細いマジック等で、ケースの高さで、線を引きます。



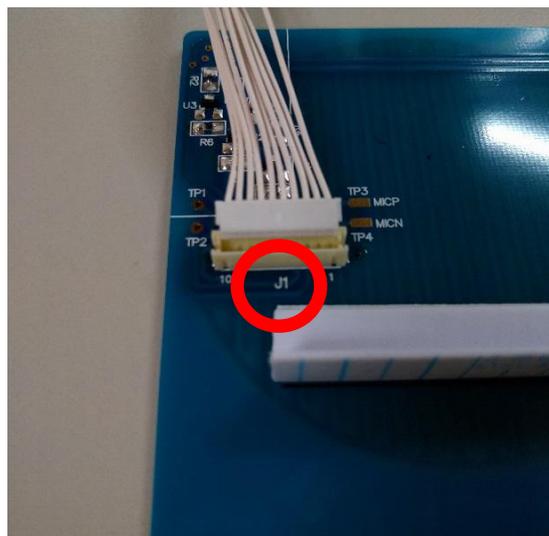
貼る位置は多少調整の必要があるかも知れません。

基板やケースから斜めにして剥がすと、  
この両面テープは剥がれ易いです。

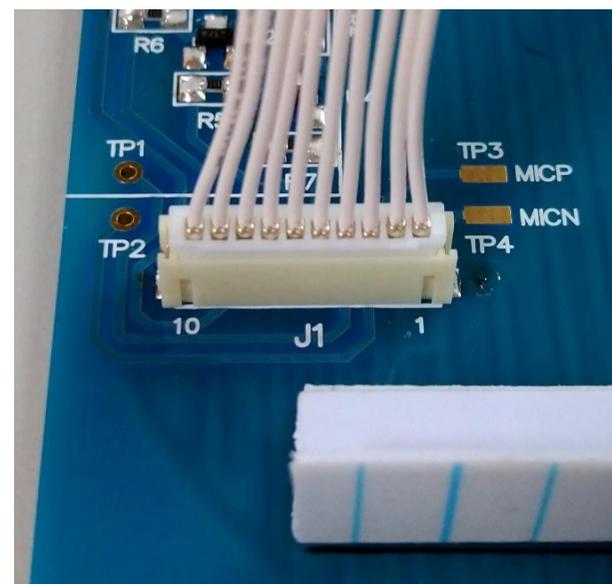
## コネクタの挿し方、抜き方。



向きが逆



正しい向き

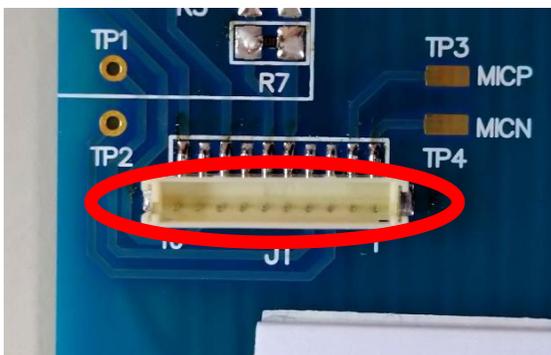


**挿すときは、なるべく垂直に、傾かないように、ゆっくり奥まで挿し込みます。**

**抜くときは、真ん中あたりの線をなるべくたくさん平行なまま挟んで持ち、少しグシグシしながら、なるべく垂直に引き抜きます。**

コネクタの両端を持つ方が良いですが、爪を怪我しやすいので上記方法で妥協を。

コネクタのピンを見ると、中心がずれているので向きが分かります。



**※線が切れたらLEDが点灯しなくなります。**

**ご連絡いただければ、本体も預かり修理致します。**

組立説明書Rev1.1 2026.2.15.

<https://unelabo.jp/ele-kit/>